

证券代码：300656

证券简称：民德电子

深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-01

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称	长城证券股份有限公司研究员：舒迪 深圳纽富斯投资管理有限公司投资总监：詹础 深圳孚悦中诚资产管理公司基金经理：陈龙
时间	2020 年 11 月 27 日
地点	公司办公室，现场及通讯结合的方式
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：许文焕 广微集成（子公司）总经理：谢刚 投资总监：高健 董事会秘书：范长征 证券事务代表：陈国兵
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司的业务和经营情况 公司主要从事条码识别设备的研发、生产和销售业务，以及半导体设计和分销业务。公司条码识别主要产品包括用于一维码、二维码信息识别和读取的手持式条码扫描器、固定式 POS 扫描器、固定式工业类扫描器等系列识读设备，目前被广泛应用于零售、物流、仓储、医疗健康、工业制造和电子商务等产业的信息化管理领域；此外，基于公司条码识别技术，公司亦涉足物流自动化产品领域，为快递物流企业提供自动化设备产品和技术服务。公司半导体设计和分销业务包含两项子业务，一是功率半导体设计业务：公司功率半导体设计业务主要产品包括沟槽式 MOS 肖特基二极管（TMBS）、超级结 MOS（CoolMOS）、快恢复二极管（FRD），主要应用在光伏逆变、电源适配器、工业 PFC 等场景。二是电子元器件分销业务：公司电子元器件代理分销产品以被动元器件（电容、电阻、电感、滤波器等）为主，并逐步拓展主动元器件系列产品线，下游主要覆盖汽车电子、移动通讯设备、云数据存储、无人机等领域的行业领先客户。 2020 年公司前三季度累计实现营业收入 225,518,202.74 元，同比增长 26.89%，实

现归属于上市公司股东的净利润 27,886,507.29 元，同比增长 20.35%。截至 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 771,924,037.53 元，较年初增长 18.79%，归属于上市公司股东的净资产 512,970,514.41 元，较年初增长 3.27%。公司 2020 年第三季度实现营业收入 109,431,978.25 元，同比增长 103.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,767,448.06 元，同比增长 77.17%。

二、互动交流及问题回复

1、公司目前的业务布局是怎样的？

答：自公司上市以来，逐步确立未来发展战略：深耕条码识别，聚焦半导体。民德电子是国内最早从事条码识别技术研发的少数企业之一，经过十余年的发展，已成为国内条码识别产业的领先企业，核心元器件已全部实现国产化，并开始逐步切入高端工业制造领域的条码识别市场；未来将以半导体化思维和摩尔定律为指导思想，不断提升现有产品的性价比，持续开发更高端的产品线，在条码识别业务市场占有率将进一步提高。在半导体领域，2018 年 6 月，公司全资收购深圳市泰博迅睿技术有限公司，正式进驻半导体元器件分销行业；2020 年 6 月，公司控股收购广微集成技术（深圳）有限公司，进入功率半导体设计行业；2020 年 7 月，公司参股投资浙江晶睿电子科技有限公司，布局半导体硅片行业。公司将逐渐形成“条码识别+半导体”的双产业成长曲线。

2、今年的新冠疫情对公司的影响如何？

答：受新冠肺炎疫情的影响，特别是在上半年，公司及上下游合作企业部分期间停工停业，公司上半年整体营业收入较上年同期减少 6.27%；同时公司营业成本、管理费用、销售费用等均较上年同期有所降低，上半年利润与去年同期基本持平，确保了公司正常运营。进入下半年以后，在政府和各部门强有力的领导下，我国各项经济活动基本恢复正常，公司业务也稳步恢复，前三季度营业收入同比增长 26.89%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 20.35%。条码识别业务上，公司产品继续保持竞争力，前三季度营业收入和产品毛利率有所提升。半导体设计业务上，广微集成 TMBS 产品销量稳步上升。半导体分销业务上，受疫情影响泰博迅睿公司的整体毛利率及盈利能力较上年有所下降。

3、公司前三季度营业收入和净利润较去年同期相比都有所增长，特别是第三季度增幅较大，主要原因是什么？

答：下半年以来我国经济活动基本恢复正常，因疫情影响上半年的部分业务和订单

在三季度完成，三季度营业收入相对较大；同时，公司本年对成本、管理费用、销售费用等严格控制，成本费用相对上年同期下降。此外，本年公司控股收购了广微集成公司，从7月份起纳入了广微集成公司的营业收入和净利润。

4、公司的条码识读产品在哪些领域有应用？

答：公司条码识读设备目前被广泛应用于零售、物流、仓储、医疗健康、工业制造和电子商务等产业的信息化管理领域。随着我国信息化建设、物联网、移动支付技术的进一步推进，以及条码识别技术在工业自动化领域应用的不断渗透，条码识别设备将迎来更加广阔的市场空间。

5、公司的条码识读产品核心元器件已全部实现国产化，市场表现如何，主要竞争优势在哪里？

答：2019年公司应用自研及合作开发芯片的二维扫码设备及模组系列新品已全面推向市场，产品性价比得到市场普遍好评和一致认可，本年产品毛利率有所提升。民德电子是中国为数不多实现自主研发条码识别设备的科技企业，目前已构建从一维码到二维码、从手持式主动扫描设备到被动式扫描平台设备、从微型扫描引擎到各类成品设备的完整产品体系，产品在解码能力、识读景深、扫描速度等技术性能上已达到或接近国际领先品牌的水平，并在不断加大对国际品牌产品的进口替代。

6、公司条码业务在海外市场的开拓情况如何？

答：公司近些年对海外市场非常重视，不断加大条码业务海外市场的开拓力度。2017-2019年期间，条码识读设备的海外销售收入保持了年均15.9%的增速。2020年前三季度，受公司产品竞争力提升、全球新冠疫情及中国较早从疫情复工复产等多重因素影响，公司条码业务的海外收入继续保持稳定增长。

7、公司今年在半导体领域的投资进展情况如何？

答：2020年6月，公司收购了广微集成技术（深圳）有限公司73.51%的股权，广微集成成为公司的控股子公司，公司正式进入功率半导体设计行业；广微集成的主营业务为功率半导体器件的自主研发、生产（生产部分主要由代工厂完成）和销售，其核心产品沟槽式MOS肖特基二极管（TMBS）已获终端多家品牌客户批量验证，2020年产销量快速增长。

2020年7月，公司向浙江晶睿电子科技有限公司投资9,000万元，持有其29.03%股权，布局半导体硅片行业。晶睿电子主营业务为6、8、12英寸高性能硅外延片的研

	发、制造和销售，并同时开展硅基 GaN 和 SiC 外延的研发和小批量生产。晶睿电子目前仍处于公司前期建设阶段。 8、广微集成目前核心产品的产能如何？近期晶圆代工产能紧缺、价格上涨，对广微集成有无影响？未来在产能提升方面有无进一步规划？ 答：广微集成目前核心产品为沟槽式 MOS 肖特基二极管（TMBS）和超级结 MOS 管（CoolMOS），目前 TMBS 产能约 6000-8000 片晶圆（6 英寸）/月，CoolMOS 产能约 100-150 片晶圆（8 英寸）/月。 近期功率半导体产业，晶圆代工产能整体较为紧缺，广微集成将通过与上游晶圆代工厂的长期、紧密合作，与晶圆代工厂共同搭建产品工艺平台，共同进行设备投入，形成稳固的合作关系。因此，广微集成上游代工产能未受影响。 因上游硅片等原材料以及行业晶圆代工费整体上涨，广微集成的原材料采购成本和晶圆代工成本也略有上升。但广微集成专注于功率半导体设计，其产品主要为进口替代产品，市场需求远大于广微集成目前可供量，所以广微集成可将上游的成本上升传导至下游客户端，并已对下游客户销售价进行了相应幅度的上调。因此，上游原材料和晶圆代工费用上涨，未对广微集成造成实质影响。 广微集成目前供需矛盾突出，产能远不能满足市场客户订单需求，因此今年以来广微集成一直在持续地进行扩产的动作：广微集成的 TMBS 产品产能，已从年初的 1000-2000 片晶圆（6 英寸）/月提升至目前的 6000-8000 片晶圆（6 英寸）/月。另，为进一步提升产能，加强与晶圆代工厂的战略合作，广微集成与其主要晶圆代工供应商——深圳方正微电子有限公司于 2020 年 11 月签署了关于产能扩增的战略合作协议，约定方正微电子 2021 年 1-6 月为广微集成产出 TMBS 产品不少于 8000 片晶圆（6 英寸）/月，2021 年 7 月以后为广微集成产出 TMBS 产品不少于 15000 片晶圆（6 英寸）/月，即年出货量不低于 6 亿颗芯片；协议期限为 3 年，扩产的设备投入由广微集成先行承担，方正微电子在协议期内回购。 9、广微集成在研发的新产品有哪些？新产品的量产规划如何？ 答：广微集成目前主要在研发的新产品为超级结 MOS 管（CoolMOS）和分离栅低压场效应晶体管（SGT-MOSFET）。其中，CoolMOS 部分系列产品已经实现量产，部分系列产品在逐步验证中，2021 年会实现 CoolMOS 全系列产品量产；SGT-MOSFET 目前已完成研发模型建立和仿真，已与意向晶圆代工厂在进行工艺平台对接，2021 年开始制版和流片
--	---

验证，预计 2021 年底可以实现量产。

10、浙江晶睿电子项目目前的进展情况如何？

答：晶睿电子项目进展一切顺利，按计划推进中。

项目融资方面，2020 年 11 月晶睿电子与丽水丽湖企业管理有限公司（系浙江省丽水市和湖州市政府共同出资成立的政府投资平台企业）签订投资协议书，丽水丽湖企业管理有限公司向晶睿电子增资 8000 万元。截止目前，晶睿电子目前累计完成融资 1.9 亿元，基本满足项目第一期建设所需资金，后续晶睿电子将根据项目进度及资金需求，适当开展银行项目贷款融资或股权融资。

项目建设方面，10 月浙江省委、省政府以视频形式举行全省扩大有效投资重大项目集中开工活动，丽水市分会场设在晶睿电子项目现场；11 月晶睿电子项目现场开始打桩，正式土建动工，预计 2021 年 4 月完成项目一期土建工程；设备采购已在陆续洽谈中，预计 2021 年 7-8 月开始小批量生产；期间，浙江省委省政府、省经信厅、丽水市委市政府和丽水经开区领导多次到访视察项目现场，希望晶睿电子立足浙江、放眼全国，以半导体硅外延片为切入点，带动半导体全链条产业的发展，做好“强链、延链、补链”文章，提高我国半导体战略新兴产业基础产业创新能力。

11、公司在功率半导体产业的投资布局规划是怎样的？后续是否还会有新的投资计划？

答：公司着力打造功率半导体的 Smart IDM 模式。Smart IDM 模式，即通过资本参股或控股的方式，打通功率半导体全产业链。在这种模式下，公司对产业链上下游各环节企业均保持足够影响力，但不谋求拥有。这种模式既保证了产业链上下游企业紧密合作，以实现特色工艺和供应链的安全稳定；又使得产业链上各家企业保持了独立的组织架构，自主的产品发展规划，充分的市场竞争意识，广阔的国际化发展空间。

高端功率半导体器件并无标准化产品，其器件参数的定义依赖于具体的应用领域。这种高度定制化的特色产品，需要产业链上下游高度的协同与合作。公司以 Smart IDM 模式打通功率半导体核心关键产业链环节，每个环节由一位具有国际化视野的产业领军人物带领，始终保持充分的市场竞争及技术迭代能力，从而解决产业链协同过程中的痛点。广微集成目前在全国国产化供应链的支持下，在中高端功率半导体器件一些细分领域的进口替代成效显著，产能持续攀升。公司投资国产化电子级大硅片外延项目——晶睿电子，为广微集成提供高品质、高度定制化的外延材料。此外，公司正在密集调研 8 英

	寸晶圆厂，努力为高端功率半导体器件的产业化，提供安全稳定的特色工艺平台保障。 接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
附件清单（如有）	无
日期	2020-11-27